证券代码：603738　　证券简称：泰晶科技　　公告编号：2026-054

泰晶科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2026 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 3336 号”《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次向特定投资者实际非公开发行人民币 A 股股票 24,587,769.00 股，每股发行价格 26.00 元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金总额为人民币 639,281,994.00 元，扣除保荐费、承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用、申报文件制作费用等发行费用 8,283,165.80 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 630,998,828.20 元，上述资金已于 2021 年 7 月 8 日全部到位，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“众环验字（2021）0100050 号”验资报告。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司于 2021 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。2021 年 7 月 21 日，公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行、交通银行股份有限公司随州分行、湖北银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 63,542.09 万元（含利息收入），募集资金已使用完毕，募集资金专户信息如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行	82010000004606934	0.00	已注销账户
交通银行股份有限公司随州分行	476476471011000032602	0.00	已注销账户
湖北银行股份有限公司随州分行	20010230000000274	0.00	已注销账户
合计		0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

2021 年 7 月 8 日募集资金到位后，由于实际募集资金净额 63,099.88 万元与募投项目承诺投资总额 63,928.20 万元之间存在差额 828.32 万元，“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额由 15,000.00 万元变更为 14,171.68 万元。

2022 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》，具体如下：

（1）募投项目新增实施地点

募投项目“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”在原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道 9 号作为实施地点，是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

（2）部分募投项目调整产品结构

公司募投产线布局和生产模式具有各型号兼容切换的特征，当前，终端方案涉及 kHz 晶体谐振器应用尚以 K3215 需求相对较大，客户升级的同时也对 K3215 产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，对“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增

K3215 产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。

本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

金额单位：人民币万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目	37,766.60	37,766.60	37,963.05	196.45	注 2
温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目	11,161.60	11,161.60	11,318.79	157.19	注 2
偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	14,171.68	14,260.25	88.57	注 1、注 2
合计	63,928.20	63,099.88	63,542.09	442.21	

注 1：2021 年 7 月 8 日募集资金到位后，由于实际募集资金净额 63,099.88 万元与募投项目承诺投资总额 63,928.20 万元之间存在差额 828.32 万元，“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额由 15,000.00 万元变更为 14,171.68 万元。

注 2：本公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与调整后承诺投入之间的差异合计 442.21 万元，主要为募集资金利息继续用于承诺投资项目所致。本次募集资金结余资金 119.25 元已永久补充流动资金。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23,969.09 万元置换公司预先以自筹资金投入的“基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目” 20,924.04 万元及“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目” 3,045.05 万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 23 日出具的“众环专字（2021）0101604 号”专项报告鉴证。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

公司不存在已对外转让的前次募集资金投资项目情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况，本公司前次募集资金结余资金 119.25 元已永久补充流动资金，前次募集资金均已使用完毕。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

（1）本公司前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（2）本公司前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充流动资金”未对应具体投资项目，用于偿还公司银行贷款及补充公司流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

（3）本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司已经按照 2020 年非公开发行股票预案及后期补充决议的运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四、上网公告附件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于泰晶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	63,099.88	已累计使用募集资金总额：	63,542.09
变更用途的募集资金总额：	未变更	各年度使用募集资金总额：	63,542.09
变更用途的募集资金总额比例：	不适用	其中：置换金额	23,969.09
		2021 年度（不含置换）	18,615.54
		2022 年度	14,342.59
		2023 年度	6,364.41
		2024 年度	250.46

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目	基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目	37,766.60	37,766.60	37,963.05	37,766.60	37,766.60	37,963.05	196.45	2022 年 12 月
2	温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目	温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目	11,161.60	11,161.60	11,318.79	11,161.60	11,161.60	11,318.79	157.19	2023 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	14,171.68	14,260.25	15,000.00	14,171.68	14,260.25	88.57	不适用
	合计		63,928.20	63,099.88	63,542.09	63,928.20	63,099.88	63,542.09	442.21	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-9 月		
1	基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目	77.24%	4,329.63	4,768.87	5,418.70	6,154.72	4,291.35	6,402.31	4,896.03	5,717.55	37,723.10	注 2
2	温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目	87.02%	-191.89	561.19	1,240.32	1,816.88	1,324.69	592.11	624.94	1,276.52	4,629.14	注 2
3	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	小计		4,137.74	5,330.06	6,659.02	7,971.60	5,616.04	6,994.42	5,520.97	6,994.07	42,352.24	

注 1：2026 年 1-9 月数据未经审计。

注 2：2023 年基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目未达到预计效益系销售价格下降导致；2025 年基于 MEMS 工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目未达到预计效益系市场订单不及预期，销售价格下降等原因导致；2026 年温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目未达到预计效益系产品销售价格未达预期导致。其他年份的项目均已达到预计效益，截止日募集资金项目累计效益已达到预计效益。